CASA标准意见表

标准名称：宽禁带半导体封装用烧结银膏技术规范

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 原内容 | 意见及建议 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.具体意见按现条文顺序依次排列，针对同一条目的不用意见应分别列出。

2.处理意见包括：采纳、部分采纳和不采纳。